

更高性能的新一代四吸嘴烧录系统 每小时产量3000颗



四支吸嘴

产品特征

- 可达最大化产出的四吸嘴设计
- UPH 3000 适用于大批量生产
- 灵活的出料方式Tray /Tape /Tube均可支持
- 配备SG H9800 通用烧录器，最大可支持32个IC同时烧录。支持烧录的IC类型有 EEPROM, NOR, Nand, MCU, CPLD, FBGA, eMMC, UFS等
- 简易便捷的校正方式可最大化减少换线时间
- 可选配Laser Marking, 2D/3D 检测模组
- 一站式操作

● System General 能达到最优产出的 四支吸嘴同步架构



先进的四吸嘴设计

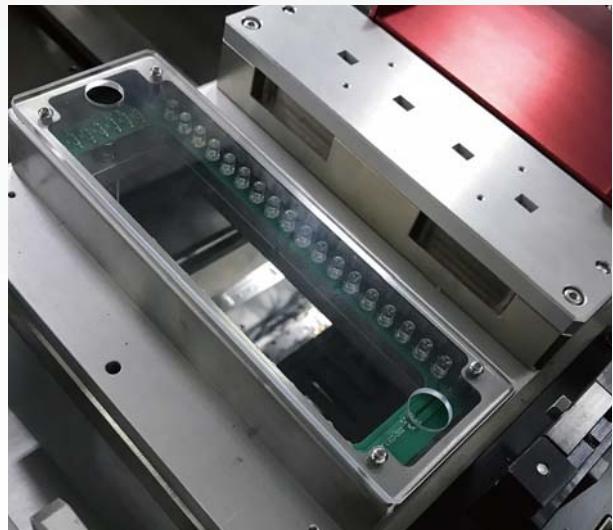
为达到3000UPH，SG5000设计四吸嘴同步取放。随着半导体工业不断向更小、更薄方向发展，System General 也持续研发出了新一代的吸嘴设计。在SG5000上，每个吸嘴有独立的真空/气流控制和取放调节。机械手臂能非常精准、稳定的同时取放4颗IC。



为达最优的UPH，配合四吸嘴的同步架构；SG5000软件更新了System General Gang4 & Gang8 烧录座和配备了4组上照式CCD

高精度多视觉校准和最小定位识别

SG5000为精准取放配备了多台上照镜头。搭配SG G4E、S4、S8 T4 Gang 系列SKB。其高效的校准机构能有助于减少每个烧录周期的校准时长。

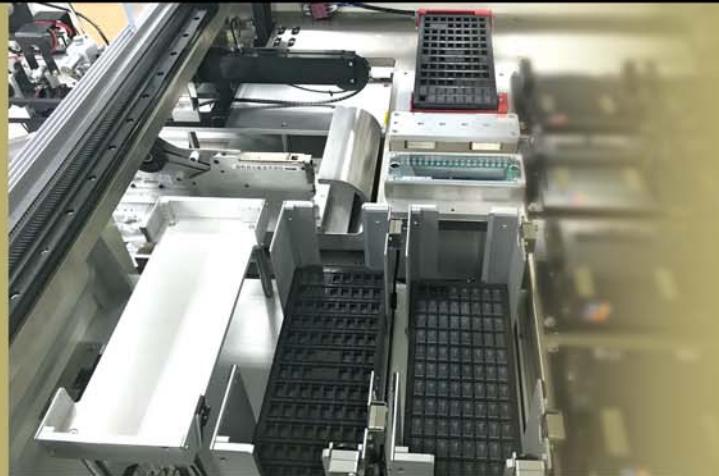


可选机械校正块

同时校正4颗IC 的取放偏差。当使用带4个Socket 的SKB时，校正块能有效减少校正时间。

一站式作业的自动烧录解决方案

SG5000 设计了一站式烧录平台，整合了烧录任务和最小的人机调整。该机型标准配置了Tray to Tray 自动进出料机构。增加了包括Tape、Tube、Laser Marking，贴标签等可选配件接口。SG 5000 Tray 机构能进行BGA、QFP、TSOP 以及其他多种尺寸封装Tray 盘搬运。一个循环最大可搬运20 Tray。



灵活的Socket board设计方式 可最大化你的烧录产出

System General 发布了新一代的单烧录座适配器和 Gang 8系列适配器。旨在将开发算法时间缩短到50%。提高了SPI、NOR、NAND MCU 在Gang适配器使用灵活性，为开发算法提供了一个灵活的烧录结构，同时为客户提供一个实惠的解决方案。烧录产出最大可提高8倍。



通用烧录器

新一代的SG8000烧录器是通用烧录器，它能支持 SPI、NOR、NAND、eMMC、MCP、PLD、CPLD、FPGA、UFS等。不仅能满足生产线高效率需求，而且也可适做用研发工具。Nand/eMMC/UFS 文档管理工具能集成多个配置需求和寄存器设定。SG8000烧录平台还提供系统报告。通过报告能帮忙用户监测烧录良率，跟踪设备性能，管理故障原因分析。SG8000也可为客制化MES提供多种应用程序接口。



SG8000 通用烧录器

SG5000

Automated Programming System

Specifications

• 机台规格 •

- ▶ 每小时产量 : 3000 UPH (0 烧录时长)
- ▶ 放置精度 : ±0.02mm
- ▶ 放置重现度 : ±0.02mm
- ▶ 放置力度 : 95克
- ▶ 取放方式 : 四支真空吸嘴
- ▶ 机台尺寸 : 1210 (长)x1310 (宽)x1500(高) mm
- ▶ 包装尺寸 : 1920 (长)x1470 (宽)x1900(高) mm
- ▶ 净重量 : 700公斤
- ▶ 包装后重量 : 750公斤
- ▶ 安全标准 : CE 认证

• 定位系统 •

- ▶ X-Y轴驱动系统 : 伺服马达驱动
- ▶ X轴精度 : 0.001mm
- ▶ Y轴精度 : 0.001mm
- ▶ X-Y轴重现度 : 0.01mm
- ▶ Z轴/Theta轴驱动系统 : 步进马达驱动
- ▶ Z轴重现度 : 0.02mm
- ▶ Theta 重现度 : 0.18度

• 定位校准系统 •

- ▶ 四吸嘴运行
- ▶ 上照式CCD *4 (标准配备)130万像素
FOV : 35mm*35mm
- ▶ 下照式CCD *1 130万像素
FOV : 35mm*35mm
- ▶ 机械校正块

• 编程系统 •

- ▶ 编程模块 : 8台SG8000 通用烧录器
- ▶ 编程socket : 可支持64颗eMMC 和 MCU/Memory 同时烧录
- ▶ 支持的芯片种类 : EPROM · EEPROM · Flash, Microcontroller, PLD, CPLD, FPGA, MCU, eMMC, UFS
- ▶ 支持封装种类 : PLCC, TSOP ,TSSOP, TQFP, PQFP, SOIC, SSOP, uBGA, CSP及其它

• 系统软件 •

- ▶ 用户接口 : 基于Window系统的HMI
- ▶ 操作系统 : Windows 10

• 操作环境要求 •

- ▶ 输入电压 : 220VAC · 单相 · 3线
- ▶ 输入行频 : 50/60Hz
- ▶ 功耗 : 2.0KVA
- ▶ 气压 : 0.4Mps~0.5Mpa
- ▶ 气流 : 50 liters/min
- ▶ 操作温度范围 : 15~30°C (59~86°F)
- ▶ 相对湿度 : 35%-90%

• 选配系统 •

- ▶ 盘装进/出料机构
- ▶ 卷带装进/出
- ▶ 管装进/出
- ▶ 打点机构
- ▶ 标签飞达
- ▶ 激光打标机



崇贸科技股份有限公司

台湾、台北、新店市北新路三段205-3号8楼
(电话) +886-2-8913-1997
(传真) +886-2-2911-1283
(网址) www.sg.com.tw
(电子邮件) info@sg.com.tw

深圳市南山区麻岭工业村七栋中钢大厦西三楼
(电话) +86-13510816270
(传真) +86-755-26710195
(网址) www.sg.com.tw
(电子邮件) Xiaodan.zhang@sg.com.tw

